

深坪府办规〔2023〕4号

坪山区人民政府办公室关于印发《深圳市
坪山区半导体与集成电路产业高质量
发展资金支持措施》的通知

各街道办事处，区直各单位，驻区各单位，区属各企业：

《深圳市坪山区半导体与集成电路产业高质量发展资金支持措施》经区政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

深圳市坪山区人民政府办公室

2023年6月21日

深圳市坪山区半导体与集成电路产业高质量发展 发展资金支持措施

第一章 总 则

第一条 【宗旨】

为落实国家、省、市关于集成电路产业发展的战略部署，促进坪山区半导体与集成电路产业高质量发展，根据《国家集成电路产业发展推进纲要》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干措施》（国发〔2020〕8号），《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025年）》《坪山区半导体与集成电路产业发展规划》等文件精神，结合坪山区实际，制定本措施。

第二条 【实施部门】

区工业和信息化局是本措施的实施部门，按《深圳市坪山区经济发展专项资金管理办法》（深坪府办规〔2023〕1号）有关规定履行职责。

第三条 【支持对象】

本措施适用于在坪山区实际从事经营活动的半导体与集成电路设计、制造、封装、测试、设备、零部件、材料企业，或提供相关半导体与集成电路产业服务的企业、机构或组织。

重点支持方向：逻辑工艺硅晶圆制造；SiC MOSFET（金属氧

化物半导体场效应晶体管)器件、IGBT4.0器件、高端MEMS、智能传感器等特色工艺制造;晶圆级封装、三维封装、Chiplet(芯粒)等先进封装测试技术;光刻、刻蚀、离子注入、沉积、检测设备先进设备及关键零部件研发和生产;光罩、高纯材料、衬底、外延、靶材、光刻胶等核心材料研发和生产;高端通用芯片、存储通用芯片和高端SoC芯片、化合物半导体芯片等芯片设计;EDA工具、关键IP核技术开发与应用。

第二章 推动产业集聚发展

第四条 【支持企业集聚发展】

(一) 半导体与集成电路制造和封装测试企业

对新设立或新迁入的半导体与集成电路制造、封装测试企业,在坪山区无自有产业用地,且落户当年或第一个会计年度实际固定资产投资5000万元以上的,经区工信部门备案,按企业实际完成固定资产投资额的10%,给予最高5000万元一次性奖励。

(二) 半导体与集成电路零部件和材料企业

对新设立或新迁入的半导体与集成电路零部件和材料企业,在坪山区无自有产业用地,且落户当年或第一个会计年度实际完成固定资产投资1000万元以上的,经区工信部门备案,按企业实际完成固定资产投资额的10%,给予最高2000万元

一次性奖励。

（三）半导体与集成电路设备企业

对新设立或新迁入的半导体与集成电路设备企业，在坪山区无自有产业用地，且落户当年或第一个会计年度实际完成固定资产投资 500 万元以上的，经区工信部门备案，按企业实际完成固定资产投资额的 15%，给予最高 1000 万元一次性奖励。

（四）半导体与集成电路设计企业

1. 对新设立或新迁入的半导体及集成电路设计企业，落户当年或第一个会计年度营业收入达到 500 万元以上的，经区工信部门备案，按当年或第一个会计年度营业收入的 10%，给予最高 100 万元一次性奖励。

2. 对新设立或新迁入的半导体及集成电路设计企业，近两年获得股权投资机构投资 2000 万元以上的，经区工信部门备案，按企业获得投资额的 5%，给予最高 300 万元一次性奖励。

第五条 【支持企业租赁产业用房】

对新设立或新迁入的半导体与集成电路制造、封装测试、零部件、材料、设备企业，经区工信部门备案，租赁生产用房的，按实际租金且不超过 50 元/平方米/月的标准，给予一年租金资助，单个企业最高资助 600 万元。

对新设立或新迁入的半导体与集成电路设计企业，经区工信部门备案，租赁研发办公用房的，按实际租金且不超过 60 元/平方米/月的标准，给予一年租金资助，单个企业最高资助 100

万元。

第三章 促进产业持续创新

第六条 【支持购买和使用 EDA 软件】

（一）对企业购买 EDA 设计工具软件（含软件升级费用）或签订正版软件授权合同的，按实际发生费用的 50%，给予最高 300 万元资助。对购买国产化 EDA 设计工具软件的，按上述比例，给予最高 400 万元资助。

（二）对企业购买深圳市公共服务平台的集成电路设计服务或利用公共服务平台使用 EDA 设计工具软件的，按实际发生费用的 30%，分别给予最高 100 万元、50 万元资助；对企业购买坪山区公共服务平台的集成电路设计服务或利用坪山区公共服务平台使用 EDA 设计工具软件的，按实际发生费用的 50%，分别给予最高 100 万元、50 万元资助。

第七条 【支持购买 IP 和 IP 复用服务】

对企业购买 IP（来源于 IP 提供商、EDA 供应商或者代工厂 IP 模块）或第三方集成电路设计公共服务平台提供的 IP 复用服务的，按实际发生费用的 50%，分别给予最高 500 万元、200 万元资助。

第八条 【支持设计企业流片】

（一）集成电路设计企业进行 MPW（多项目晶圆）项目，按

MPW 直接费用的 50%，给予单个企业年度最高 300 万元资助。利用坪山区企业开展 MPW 的，按上述比例，给予单个企业年度最高 500 万元资助。

（二）对集成电路设计企业首次完成掩膜（Full Mask：IP 授权费、掩膜版费、加工费等）工程产品流片项目，按企业流片费用的 30%，给予最高 500 万元资助。对利用坪山区集成电路生产线首次完成掩膜工程产品流片的，按企业流片费用的 30%，给予最高 600 万元资助。

第九条【支持车规级资质认证】

对企业通过 IATF16949 或 ISO26262 体系认证，且产品通过 AEC-Q100（IC）、AEC-Q101（分立器件）、AEC-Q 102（光电器件）、AEC-Q 103（MEMS 传感器）、AEC-Q 104（多芯片模组）、AEC-Q200（被动组件）、AQG324（功率模块）等汽车电子车规级认证的，按照每款产品认证费用的 50%，给予单个企业年度最高 100 万元资助。

第四章 优化产业配套环境

第十条【支持运营公共技术服务平台】

对坪山区国家级集成电路公共技术服务平台、分中心，上年度为坪山区企业提供 10 家次以上服务的，按实际发生运营成本的 80%，给予运营单位年度最高 100 万元资助。

第十一条 【支持人才引进留用】

对已在坪山区半导体与集成电路企业工作一年以上的半导体及集成电路技术研发、工程技术骨干和高级管理人才，根据个人上年度企业应税工资总额的标准给予资助。具体资助标准如下：

1. 对集成电路制造领域的技术研发、工程技术骨干和高级管理人才，应税工资总额 40 万元（含）-60 万元（不含），给予 8 万元资助；60 万元（含）-80 万元（不含），给予 15 万元资助；80 万元及以上的，给予 20 万元资助。

2. 对集成电路设计、核心设备和零部件、关键材料领域的技术研发和工程技术骨干人才，应税工资总额 50 万元（含）-80 万元（不含），给予 15 万元资助；80 万元及以上的，给予 20 万元资助。

第十二条 【支持企业建设专业空间】

对企业建设洁净室（万级及以下），上年度投入 100 万元以上的，按实际投入费用的 20%，给予最高 200 万元资助。

第十三条 【支持企业融资】

对企业从坪山区银行获得 1 年期以上贷款的，按实际支付利息的 50%且贷款利率不超过同期 LPR（贷款市场报价利率）平均值的标准，给予最高 500 万元资助。

第五章 附 则

第十四条 【其他事项】

（一）本措施对单个企业的资助和奖励总额不受企业上一年度在坪山区的财力贡献限制。与坪山区其他优惠政策同类的由企业按就高不就低的原则选择适用，不重复资助。执行期间如遇国家、省、市、区有关政策调整的，按新政策执行。

（二）同一项目不可同时申报本措施第四条第（四）款中第1项和第2项的资助。

（三）坪山区企业在对口帮扶地区投资设立的企业均可享受本措施的政策，单个企业年度资助和奖励总额最高500万元。

（四）本措施规定的“以上”“最高”“不超过”，均包含本数。

（五）本措施中的“IP”指的是具有知识产权的、已经设计好并经过验证的、可重复利用的集成电路模块。

（六）对集成电路领域的重点企业和重大投资项目，由坪山区人民政府按“一事一议”的方式进行审议。采取“一事一议”方式给予支持的项目，不再享受本政策同类型条款的资助。

（七）本措施自2023年7月3日起施行，有效期至2025年12月31日，由坪山区人民政府授权区工业和信息化局负责解释。

附件

适用对象主营业务目录

1. 集成电路芯片设计及服务，芯片设计平台（EDA 工具）及配套 IP 库。

2. 集成电路芯片制造，线宽 100 纳米及以下大规模数字集成电路制造，0.5 微米及以下模拟、数模集成电路制造。

3. 集成电路芯片封装测试，包括晶圆级封装、系统级封装（SiP）、多芯片组件封装（MCM）、芯片级封装（CSP）、圆片级封装（WLP）、球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、覆晶封装（Flip Chip）、硅通孔（TSV）、扇出晶圆级封装（Fan-Out）、三维封装（3D）等先进封装和测试技术的开发及产业化。

4. 半导体与集成电路材料。主要包括 6 英寸/8 英寸/12 英寸集成电路硅片、绝缘体上硅（SOI）、化合物半导体材料（含 SiC、GaN 等第三代半导体材料），光刻胶、蚀刻液、靶材、抛光液、研磨液、电镀液功能添加剂、氟化冷却液、封装材料等。

5. 半导体与集成电路设备。主要包括集成电路制造设备、封装设备、测试设备和材料设备。

6. 半导体与集成电路零部件。电源和射频控制类零部件、气体输送类零部件、真空控制类零部件、温度控制类零部件、传送装置类零部件。

7. 半导体产品。主要包括集成电路、功率器件、汽车芯片、半导体传感器、MEMS 等。